

证券代码：003031

证券简称：中瓷电子

河北中瓷电子科技股份有限公司

通信行业上市公司 2024 年度集中路演

投资者活动记录表

编号：2024-04

投资者关系 活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他： <u>路演活动</u> <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称 及人员姓名	通信行业上市公司2024年度集中路演采用网络远程方式进行，面向全体投资者
时间	2024年9月25日 15:00-17:00
地点	深圳证券交易所“互动易平台” http://irm.cninfo.com.cn “云访谈”栏目
公司接待人 员 姓名	主持人：中瓷电子 总经理：付花亮 董秘，财务总监：董惠 副总经理：赵东亮 中信证券股份有限公司投行委工业与先进制造：肖尧
投资者关系 活动	

<p>主要内容介绍</p>	<p>1.公司下半年光通讯领域订单是否有大幅增长？公司对明年的预期如何？</p> <p>答：您好，2024 年光通信市场的繁荣给公司光通讯相关产品领域订单带来了一定增长，公司上半年氮化铝多层薄厚膜实现批量出货并实现高速增长，产品应用于 400G/800G 等高频高速光模块中，应用于 AI 智能和数据中心等新场景。公司时刻关注该类产品更新换代趋势，紧跟市场及技术方向来加快新产品开发，项目产品结构将随市场需求变化而调整。公司在积极开展现有业务的同时，也在不断探索和跟进行业发展趋势及市场需求，感谢您的关心。</p> <p>2.公司产品涉及无人驾驶或者辅助驾驶领域吗？</p> <p>答：您好，中瓷电子消费电子陶瓷外壳及基板产品，主要包括声表晶振类外壳、3D 光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板等，其中，声表晶振类外壳在智能手机、AR/VR、智能手表、TWS 等移动智能终端，以及无线通讯、汽车电子、医疗设备等消费电子领域应用广泛。另外，汽车电子件系列产品主要包括陶瓷元件、集成式加热器、激光雷达用陶瓷外壳等。其中汽车电子用陶瓷外壳主要用于传统燃油车和新能源汽车用 MEMS 传感器、激光雷达等器件封装。激光雷达用陶瓷外壳可用于封装激光雷达的激光器和探测器，可满足车规级高可靠的要求，应用于新能源汽车的自动驾驶领域。MEMS 传感器陶瓷外壳应用于传统燃油车和新能源汽车、智能驾驶、物联网等领域。感谢您的关心。</p>
---------------	--

3.你好，下半年公司运营计划

答：您好，公司经营计划包括：1、促进重组后公司业务有效融合，提升上市公司整体盈利能力。在上市公司整体经营目标和战略规划下，在业务、资源、资产、财务、人员和机构等方面对重组标的资产进行整合管理，促进业务有效融合，优化资源配置，提高经营效率和效益，提升上市公司整体盈利能力。2、加强募集资金管理，推进“重组募投项目”建设。加强募集资金管理，积极推进“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”的建设。3、加强技术创新，加快发展新质生产力。凭借重组后公司优秀、稳定的技术团队，雄厚的研发实力和科技创新能力，实现关键性颠覆性技术突破，加快发展新质生产力。感谢您的关心！

4.子公司国联万众生产的碳化硅汽车芯片是否已经批量用于比亚迪汽车？在其他领域是否有布局？客户的对接情况如何？

答：您好，目前国联万众碳化硅汽车芯片已在比亚迪汽车上批量应用。公司目前已逐步打开国内 SIC 市场，市场开拓情况良好，按照公司规划除了汽车、家电、消费电子等，还在布局光伏逆变、充电桩等领域，随着终端市场需求回升，器件端的需求也会逐步释放。公司 SIC 系列半导体产品的客户，也在与多家客户开展合作，客群群体多样。此外，

公司已与多家车企持续对接，多款产品已经在客户端开始测试验证。
产能供应能够满足客户需求，感谢您的关心。

5.公司在 6G 方面有没有技术储备？有没有研发新产品？

答：您好。博威公司积极推进 5G-A、6G、星链通信等新一代通信系统用射频芯片与器件关键技术突破和研发工作，目前公司在 5G-A、6G 和星链通信相关芯片与器件领域储备关键技术，根据用户需求，稳步推进产品开发和验证工作，感谢您的关心。

6.公司的半导体设备零部件可以用在哪些设备？

答：您好，公司精密陶瓷零部件采用氧化铝、氮化铝等先进陶瓷经精密加工后制备的半导体设备用核心零部件，具有高强度、耐腐蚀、高精度等优异性能，应用于刻蚀机、涂胶显影机、离子注入机等半导体关键设备中。感谢您的关注。

7.已建成投产的消费电子项目产能情况如何？产品主要应用于哪些领域？

答：您好，公司消费电子陶瓷外壳生产线建设项目，已于 2023 年底竣工投产。公司消费电子陶瓷外壳及基板系列产品主要包括声表晶振类外壳、3D 光传感器模块外壳、氮化铝陶瓷基板等，其中声表晶振类外壳主要用于晶体振荡器和声表滤波器封装，结构形式主要是 SMD，在智能手机、AR/VR、智能手表、TWS 等移动智能终端，以及无线通

讯、汽车电子、医疗设备等消费电子领域应用广泛。公司将时刻关注电子产品更新换代趋势，紧跟市场及技术方向来加快新产品开发，项目产品结构将随市场需求变化而调整。感谢您的关心。

8.请问公司作为一家科技企业有何原创性的技术？

答：您好，公司在氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及其应用、电子陶瓷等核心业务领域均有自主知识产权。感谢您的关心。

9.如何看待新质生产力？

答：您好，当前新质生产力成为中国经济的高频词汇，新质生产力特点是创新，关键在质优，本质是先进生产力。公司及各分子公司设备自动化程度一直维持在较高的水平，同时，公司也将继续加大研发投入，推动科技创新，加强关键核心技术攻关，力争取得更多科技创新成果，大力提升核心竞争力，推动企业做强做优做大，为推动公司高质量发展做出更大贡献。感谢您的关心。

10.公司前段时间公告公司募集资金投资项目“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”和“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”的实施地点由原博威公司自有土地更改为拟竞标取得土地，请问付总为何非要更改为竞投土地？这难道不是平白无故地增加了募投项目的土地成本么？公司为何不能节约一些用竞购土地的资金来多购买一些

生产设备为公司创造利润呢？

答：您好，本次变更募集资金项目地点，有利于募集资金实施项目实施和管理，优化项目布局，统筹规划项目建设，推进募集资金项目顺利实施。符合经营发展需要。本次变更仅涉及项目实施地点的变动，是公司根据自身战略布局及实际需要而做出的审慎决定，不会对募集资金投资项目产生实质影响，不存在损害股东利益的情形。感谢您的关心。

11.公司在 2023 年年度报告中披露，在完成重大资产重组后，公司在 2024 年将重点推进“重组募投项目”建设，包括“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”。请公司介绍下上述募投项目的进展情况，项目进度是否符合预期，项目推进过程中存在的风险及解决措施。

答：您好，公司重组各项募投项目均按计划有序推进，公司已于 2024 年 8 月 28 日披露《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募集资金投资的公告》，为有效推进“第三代半导体工艺及封测平台建设项目”“碳化硅高压功率模块关键技术研发项目”的实施建设以及满足国联万众流动资金需求，公司拟使用募集资金向国联万众增资 110,000.00 万元，其中，90,000.00 万元用于国联万众募投项目建设，20,000.00 万元用于补充国联万众流动资金。公司已于 2024 年 8 月 28 日公告，

变更了“氮化镓微波产品精密制造生产线建设项目”“通信功放与微波集成电路研发中心建设项目”两个项目的地块，目前四个募投项目都在抓紧建设中。感谢您的关心。

12.证监会昨天发布关于市值管理的征求意见稿，鼓励上市公司重视公司自身价值进行股份增持和市值管理，请问付总公司自去年以来股价已经跌去四分之三，公司及公司高管们是否准备进行增持？公司是如何看待市值管理的？公司为稳定股价做过哪些具体工作？

答：您好，公司管理层重视并密切关注股价情况，但公司股价受二级市场整体波动影响较大。公司将持续做好经营管理工作，推动公司持续稳定发展，凸显公司内在价值；同时，公司重视投资者关系管理，建立多层次良性互动机制，及时、准确、完整地向投资者传递公司信息。感谢您的关心。

13.公司子公司博威集成电路中期业绩并没有因为三大运营商 5G 投资减少而出现令广大投资者担心的业绩下降问题，反而是中瓷电子的业绩逆光模块行业高景气度出现业绩下降令投资者感到不解，请问付总，这是否是公司对未来趋势的判断出现严重错误造成的？在 AI 大幅增长的趋势下为何中瓷电子没能抓住机遇高速成长？公司高管是否存在思想保守缺乏创新意识？公司能否将利润增长作为业绩考评的唯一评判标准？

答：您好！博威公司 2024 年积极推动降本增效工作，取得了初步成效；

	<p>同时，博威公司积极推进低空经济等新型应用场景的新产品开发，依托技术和产品优势，在 2024 年形成了一定市场规模，保持了业绩增长。光通信市场的繁荣给中瓷电子光通讯相关产品领域订单带来了增长，但产品结构的转型、新产品产能爬坡需要过程，加之金价等原材料的大幅上涨，使中瓷的经营业绩出现了阶段性波动，中瓷已根据市场形势的变化，积极拓展业务，按计划顺利推进新产品研发等工作，争取在新产品领域进一步扩大市场范围。感谢您的关心！</p>
附件清单	无
日期	2024 年 9 月 25 日